

Title (en)

Process for the firmly adhering metallisation of an enamel.

Title (de)

Verfahren zur haftfesten Metallisierung von Emails.

Title (fr)

Procédé de métallisation adhérente d'email.

Publication

EP 0307585 A2 19890322 (DE)

Application

EP 88111820 A 19880722

Priority

DE 3731167 A 19870914

Abstract (en)

A process wherein the enamel surface is first roughened and simultaneously or subsequently treated with ultrasound, the surface is then conditioned by means of a wetting agent, subsequently activated and then chemically metallised.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur haftfesten Metallisierung von Emails, dadurch gekennzeichnet, daß die Emailoberfläche zunächst aufgeraut wird, wobei gleichzeitig mit der Aufrauhung oder darauffolgend eine Ultraschallbehandlung erfolgt, worauf die Oberfläche mittels eines Netzmittels konditioniert, anschließend aktiviert und dann chemisch metallisiert wird.

IPC 1-7

C03C 17/10

IPC 8 full level

H05K 3/18 (2006.01); **C03C 17/10** (2006.01); **C23C 18/18** (2006.01); **C23C 28/00** (2006.01); **C23D 13/00** (2006.01); **H05K 1/05** (2006.01); **H05K 3/38** (2006.01)

CPC (source: EP US)

C03C 17/10 (2013.01 - EP US); **C23C 18/1855** (2013.01 - EP US); **C23C 18/1893** (2013.01 - EP US); **H05K 1/053** (2013.01 - EP US); **H05K 3/181** (2013.01 - EP US); **H05K 3/381** (2013.01 - EP US); **Y10T 428/31678** (2015.04 - EP US)

Cited by

WO9010609A1

Designated contracting state (EPC)

BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0307585 A2 19890322; **EP 0307585 A3 19900627**; DE 3731167 A1 19890511; JP H01129981 A 19890523; US 4948674 A 19900814

DOCDB simple family (application)

EP 88111820 A 19880722; DE 3731167 A 19870914; JP 22766688 A 19880913; US 24159488 A 19880907